

Pressemitteilung

Verkapselungslösungen aus Dresden auf der ICCG 10

Das Cluster FLEET - Flexible Electronics Encapsulation Technologies Dresden bündelt Kompetenzen von vier Dresdner Institutionen und einem Dresdner Unternehmen und stellt seine Kompetenzen auf der ICCG 10 (The International Conference on Coatings on Glass and Plastics - Advanced Coatings for Large-Area or High-Volume Products) vor

Dresden, den 25. Februar 2014: Flexible Elektronik rückt mehr und mehr in den Fokus der industriellen Produktentwicklung. So steht die Technologie der organischen Elektrolumineszenz auf dem Sprung zur breiteren Markteinführung. Dem daraus resultierenden Bedarf an hochwertigen Funktionsfolien für die industrielle Fertigung muss daher Rechnung getragen werden. Flexible Solarzellen auf Basis anorganischer oder organischer Halbleiter und flexible organische Leuchtdioden (OLED) eröffnen neue Möglichkeiten für die Integration von Photovoltaik oder intelligenter Beleuchtung in Gebäuden und Alltagsgegenständen. Auch flexible Bildschirme oder innovative Pharma- und Kosmetikartikelpackungen sind in Entwicklung. Alle diese Anwendungen haben aber eines gemeinsam: die aktiven Schichten müssen vor Feuchtigkeit und Sauerstoff geschützt werden, um zuverlässig mit ausreichender Produktlebensdauer zu funktionieren.

Technologien zur Verkapselung dieser flexiblen elektronischen Bauelemente befinden sich heute noch größtenteils im Forschungs- oder bestenfalls im Pilotstadium. Das Cluster FLEET – eine Fraunhofer Initiative - vereint die Kompetenzen von drei Fraunhofer Institutionen (FEP, IWS und COMEDD), einem Institut der Technischen Universität Dresden (IAPP) und einem mittelständischen Unternehmen (SEMPA Systems) in diesem Fachgebiet. Das Ziel des Clusters ist eine rasche Weiterentwicklung von Verkapselungstechnologien zur Industrie- und Serienreife durch die Intensivierung der Zusammenarbeit entlang der Wertschöpfungskette konzentriert an einem Standort.

„In jahrelanger Projekt- und Forschungsarbeit konnten die Mitglieder des Clusters ein einzigartiges Portfolio an Know-how erwerben, das sie nun in enger Zusammenarbeit mit der Industrie und mit Forschungspartnern kompakt anbieten können.“, freut sich Dr. Christian May vom Fraunhofer COMEDD und Sprecher des Clusters.

Die Cluster-Mitglieder profitieren von der räumlichen Nähe und modernster anlagen- und messtechnischer Ausstattung und pflegen einen intensiven wissenschaftlichen Austausch, um stets Dienstleistungen auf höchstem Niveau anbieten zu können. Die gute Vernetzung in der Welt der flexiblen Elektronik führt zu einer regen Nachfrage durch Industrieunternehmen, um so mit den Wissenschaftlern gemeinsam in Projekten an den Technologien von morgen zu arbeiten.

Die Kompetenzen des Clusters umfassen die Entwicklung und Pilotierung von Verkapselung, das Testen von Materialien und die Verkapselung von organischen Bauelementen durch Glas oder Folien, die mit einer Dünnschichtverkapselung kombiniert werden kann. Das Cluster bildet die gesamte Prozesskette der Herstellung von organischer Elektronik und Funktionsfolien bis zu Prototypen und Kleinserienfertigung auf starren und flexiblen Substraten ab. Sogar im Rolle-zu-Rolle-Verfahren konnten flexible OLED-Bauelemente durch direkte Beschichtung sowie mit selbstklebenden Verkapselungsfolien bereits erfolgreich verkapselt werden.

Das Cluster stellt sich dem internationalen Publikum auf der **Konferenz ICCG 10, vom 22.-26. Juni 2014, in Dresden** vor.

Über das Cluster Flexible Electronic Encapsulation Technology Dresden FLEET:

www.high-barrier-technologies.com

Mitglieder: Fraunhofer COMEDD, Fraunhofer FEP, Fraunhofer IWS, SEMPA Systems und das IAPP der TU Dresden

Weitere Informationen sind erhältlich:

Fraunhofer Flexible Electronic Encapsulation Technology Dresden FLEET

Ines Schedwill

Tel.: +49 (0) 351/8823-238

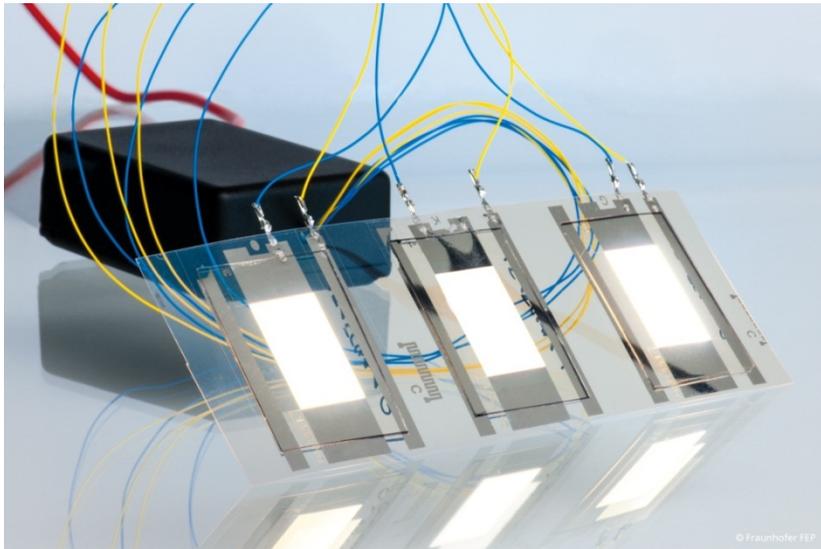
Leiterin Marketing

Fax: +49 (0) 351/8823-394

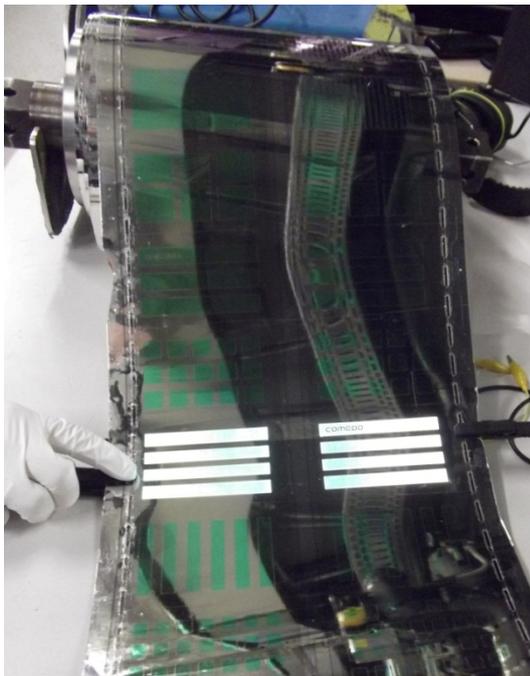
Maria-Reiche-Str. 2

e-mail: info@high-barrier-technologies.com

01109 Dresden



Verkapselte OLED auf flexibler Folie



Flexible OLED auf Metallfolie